# 02;06;10;12 Гетероструктуры GaAsN/GaAs и InGaAsN/GaAs, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии

#### © А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, А.Р. Ковш, В.М. Устинов, В.В. Мамутин, С.В. Иванов, В.Н. Жмерик, А.Ф. Цацульников, Д.А. Бедарев, П.С. Копьев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, РАН,С.-Петербург

Поступило в Редакцию 2 июля 1998 г.

Методом молекулярно-пучковой эпитаксии получены гетероструктуры GaAsN/GaAs и InGaAsN/GaAs и исследовано влияние режимов выращивания на их характеристики. Показано, что внедрение азота приводит к существенному длинноволновому сдвигу излучения. На основе квантовых ям In<sub>0.28</sub>Ga<sub>0.72</sub>As<sub>0.97</sub>N<sub>0.03</sub>/GaAs продемонстрирована возможность получения излучения с длиной волны 1.4  $\mu$ m при комнатной температуре.

#### Введение

Источник света, излучающие в диапазоне  $1.3-1.55 \,\mu$ m, весьма перспективны для применений в устройствах волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Однако данное важное направление исследований и разработок остается за пределами современной лазерной технологии на базе GaAs вследствие фундаментального ограничения на длину волны излучения, достижимую в гетероструктурах GaAs/InGaAS (~  $1.1 \,\mu$ m), обусловленного большим различием постояных кристаллической решетки. В настоящее время полупроводниковые структуры для оптоэлектронных приборов в данном оптическом диапазоне синтезируются на основе материалов InGaAsP/InP. Недостатком лазеров на основе подобных структур является низкая температурная стабильность характеристик вблизи комнатной температуры вследствие недостаточного электронного ограничения. К тому же качество подложек InP существенно ниже, а стоимость гораздо выше, чем у подложек GaAs. Недавно было показано, что использование четырехкомпонентного соединения InGaAsN и гете-

81

роструктур InGaAsN/GaAs может быть весьма перспективно для улучшения характеристик лазеров для ВОЛС, так как позволяет существенно увеличить длину волны излучения гетероструктур на основе GaAS и улучшить температурную стабильность лазеров, излучающих вблизи 1.3  $\mu$ m [1–3]. В настоящей работе мы сообщаем о выращивании методом молекулярно-пучковой эпитаксии гетероструктур InGaAsN/GaAs на подложках GaAs, излучающих на длине волны 1.4  $\mu$ m при комнатной температуре и содержащих 3 % N в четырехкомпонентном соединении.

#### Эксперимент

Структуры выращивались методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) на полуизолирующих подложках GaAs (100) в установке ЭП-1203, оснащенной турбомолекулярным насосом Leybold-Heraeus со скоростью откачки 5601/s. В ходе настоящей работы использовались стандартные твердотельные источники Ga, In и As. Для создания потока активных радикалов азота на поверхность роста использовался источник СВЧ газового разряда с электронно-циклотронным резонансом (ECR) Astex, с рабочей частотой 2.45 GHz. Слои GaAsN толщиной 0.2 µm и квантовые ямы (КЯ) InGaAsN/GaAs выращивались на буферном слое GaAs толщиной 0.1 µm. Структуры с КЯ заканчивались прикрывающим слоем GaAs толщиной 0.1 µm. Скорость роста GaAs в наших экспериментах составляла 0.5-1.0 µm/h. Калибровка скорости роста GaAs осуществлялась путем измерения периода осцилляций интенсивности рефлекса дифракционной картины быстрых электронов на отражение (RHEED), а InAs — по возникновению характерной дифракционной картины островкового роста на поверхности GaAs. Образцы были выращены в As-обогащенных условиях при потоке As, примерно в два раза превосходящем значение, необходимое для поддержания RHEED картины  $2 \times 4$  при росте GaAs. Люминесценция возбуждалась Ar<sup>+</sup> лазером ( $\lambda = 514.5$  nm, P = 0.4 W) и регистрировалась германиевым фотодиодом.

### Результаты и их обсуждение

В ходе работы было исследовано влияние режима работы источника азота и скорости роста (определяемой потоком Ga) на внедрение азота в эпитаксиальные слои GaAsN. Установлено, что использование относи-

тельно высоких значений мощности СВЧ разряда (~ 150 W) позволяет эффективно внедрять азот в растущий слой и получать высокие значения концентрации N (до ~ 12%) при используемых нами скоростях роста. Однако при этом в процессе роста происходит постепенное преобразование характерной для планарного роста GaAS картины RHEED в картину, состоящую из точек, расположенных на основных рефлексах, что соответствует образованию поверхности, шероховатой на микроуровне. При закрытии заслонок источников элементов третьей группы наблюдался переход от картины RHEED, соответствующей поверхностной реконструкции ( $\times$ 4), на картину с реконструкцией ( $\times$ 3), которая характерна для образования поверхностного слоя с высоким содержанием N. При низких значениях СВЧ мощности, подводимой к источнику (~ 25 W), и скорости роста 0.7 µm/h рост проходил в условиях поверхностной реконструкции (×4) и концентрация N в эпитаксиальных слоях уменьшалась до 2%. При закрытии заслонок источников элементов третьей группы картина RHEED не изменялась. Было обнаружено, что уменьшение скорости роста с 0.7 до 0.4  $\mu$ m/h (P = 25 W) приводит к увеличению концентрации азота в слоях в два раза (до 4%), поток Аз при этом оставался неизменным. Данный результат указывает, по-видимому, на существенные различия в механизмах встраивания атомов N и As в эпитаксиальные слои GaAsN, выращиваемые методом МПЭ.

На рис. 1 представлены спектры фотолюминесценции (ФЛ) слоев GaAsN, исследованных в настоящей работе. Слой GaAs<sub>0.98</sub>N<sub>0.02</sub> демонстрирует высокую интенсивность ФЛ при температурах комнатной и жидкого азота. Наличие двух пиков (1.11 и 1.18 eV) в спектре, измененном при 77 К, может быть обусловлено наличием неоднородностей в распределении состава твердого раствора, т.е. локальных областей, обогащенных N. В пользу данной интерпретации говорит наличие лишь одного пика в спектрах, измеренных при комнатной температуре и при 77 К после отжига образца в камере роста в потоке As при 700°C. Несмотря на наличие неоднородностей, материал характеризуется достаточно высоким структурным совершенством, что иллюстрируется соответствующей рентгеновской кривой качания (вставка на рис. 1). Максимум пика кривой качания, соответствующий слою GaAsN, находится в положении 1130 угловых секунд от пика подложки и имеет полуширину 97 угловых секунд. Увеличение концентрации N в твердом растворе приводит к уменьшению интенсивности ФЛ (рис. 1), в слое GaAs<sub>0.96</sub>N<sub>0.04</sub> не удается зарегистрировать сигнала ФЛ при комнатной температуре, а в слое GaAs<sub>0.88</sub>N<sub>0.12</sub> ФЛ отсутствует даже при низких



**Рис. 1.** Спектры фотолюминесценции слоев  $GaAs_{1-x}N_x$  толщиной 0.2  $\mu$ m, выращенных на подложках GaAs (100). На вставке приведена рентгеновская кривая качания (вблизи отражения 004) для  $GaAs_{1-x}N_x$ , x = 0.02. D — угол дифракции. I - x = 0.02, 77 K, 2 - x = 0.02, 300 K, 3 - x = 0.04, 77 K.

температурах. Последнее, очевидно, связано с образованием дислокаций несоответствия в упругонапряженном слое с толщиной, превышающей критическую. Таким образом, наибольшая длина волны излучения слоев GaAsN, которую удается получить при комнатной температуре, составляет порядка 1.12  $\mu$ m, что хорошо соответствует данным работы [4].



Рис. 2. Спектры фотолюминесценции КЯ  $In_yGa_{1-x}As_{1-x}N_x/GaAs$  при 300 и 77 К. I - y = 0.20, x = 0, ширина КЯ 10 nm, 2 - y = 0.20, x = 0.02, 10 nm, 3 - y = 0.28, x = 0.03, 7 nm.

Использование квантовых ям InGaAsN/GaAs позволяет значительно увеличить длину волны излучения по сравнению со слоями GaAsN [2]. В настоящей работе мы исследуем вклад N и In в длинноволновый сдвиг излучения твердого раствора InGaAsN и демонстрируем возможность увеличения длины волны вплоть до  $1.4 \,\mu m$  (300 K) путем использования квантовых ям на основе твердых растворов InGaAsN. На рис. 2 представлены спектры ФЛ гетероструктур с квантовыми

ямами In<sub>0.20</sub>Ga<sub>0.80</sub>As<sub>0.98</sub>N<sub>0.02</sub> (100 Å), In<sub>0.28</sub>Ga<sub>0.72</sub>As<sub>0.97</sub>N<sub>0.03</sub> (70 Å) и  $In_{0.20}Ga_{0.80}As$  (100 Å) при комнатной температуре и температуре жидкого азота. Видно, что введение 2% N в твердый раствор In<sub>0.20</sub>Ga<sub>0.80</sub>As позволяет увеличить длину волны излучения квантовой ямы на 286 meV (77 K) и 257 meV (300 K). Большая полуширина пиков четырехкомпонентных твердых растворов и более слабая зависимость энергетического положения пика от температуры, по-видимому, обусловлены наличием состояний, связанных с локальными неоднородностями в InGaAsN. Одновременное увеличение содержания In и N в твердом растворе позволяет еще дальше сдвинуть излучение в длинноволновую сторону и зарегистрировать сигнал ФЛ с максимумом при 1.4 µm (300 K). Интенсивность ФЛ структур с КЯ InGaAsN быстро убывает по мере увеличения концентрации N и заметно уступает структурам (In, Ga)As, и требуется дальнейшая работа по оптимизации режимов роста структур InGaAsN/GaAs с целью уменьшения концентрации дефектов и центров безызлучательной рекомбинации. В то же время относительно высокая интенсивность фотолюминесценции толстого слоя GaAsN с содержанием азота 2%, а также результаты рентгеновских измерений свидетельствуют о достаточно высоком структурном совершенстве выращенного твердого раствора. Таким образом, одним из путей дальнейшего увеличения длины волны излучения азотсодержащих гетероструктур, выращенных на подложках GaAs, а также увеличения интенсивности сигнала люминесценции является использование гетероструктур GaAs-GaAsN-GaAsInN-GaAsN-GaAs, другими словами, помещение КЯ GaInAsN в матрицу GaAsN с содержанием азота, не превышающим 2-3%.

#### Заключение

Методом молекулярно-пучковой эпитаксии выращены гетероструктуры GaAsN/GaAs и InGaAsN/GaAs. Исследовано влияние CBЧ мощности источника азота и скорости роста на характеристики слоев GaAsN. Продемонстрирована возможность получения излучения с длиной волны  $1.4 \,\mu$ m при комнатной температуре, что весьма перспективно для создания приборов для ВОЛС на основе GaAs.

Данная работа выполнена при поддержке Программы Министерства науки и технологий РФ "Физика твердотельных наноструктур".

87

## Список литературы

- Kondow M., Uomi K., Niwa A., Kitatani T., Watahiki S., Yazawa Y. // Jpn. J. Appl. Phys. 1996. V. 35. P. 1273.
- [2] Xin H.P., Tu C.W. // Appl. Phys. Lett. 1998. V. 72. P. 2442.
- [3] Nakahara K., Kondow K., Kitatani T., Yazawa Y., Uomi K. // Elecron. Lett. 1997. V. 32. P. 1585.
- [4] Francoeur S., Sivaraman G., Qiu Y., Nikishin S., Temkin H. // Appl. Phys. Lett. 1998. V. 72. P. 1857.